

2021-2026年中国半导体测试设备市场供需现状及 投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国半导体测试设备市场供需现状及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/yzsb/705090.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体测试机是半导体测试设备中的一种。半导体（专用）设备是专门用于集成电路生产的工艺装备，半导体测试设备是用于测试集成电路性能的一类半导体设备。常用的芯片（中后道）测试设备有：测试机、分选机、探针台等。

近年来，全球半导体设备市场规模呈波动上升态势，2020年全球市场规模达711.9亿美元，同比增长19.15%。预计到2022年将突破千亿美元。

2011-2022年全球半导体设备市场规模及增长趋势

随着我国半导体产业的不断发展，半导体检测设备也随之快速发展，2020年全球半导体测试设备市场规模达60.1亿美元，同比增长19.72%。预计2022年其市场规模有望超过80亿美元。

2019-2022年全球半导体测试设备市场规模及增速

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体测试设备行业基本概述

1.1半导体的定义和分类

1.1.1半导体的定义

1.1.2半导体的分类

1.1.3半导体的应用

1.2半导体测试设备行业概述

1.2.1行业概念界定

1.2.2行业主要分类

第二章 2016-2020年中国半导体测试设备行业发展环境PEST分析

2.1政策环境（Political）

2.1.1半导体产业政策汇总

2.1.2半导体制造利好政策

2.1.3工业半导体政策动态

2.1.4产业投资基金的支持

2.2经济环境（Economic）

2.2.1宏观经济发展概况

2.2.2工业经济运行情况

2.2.3经济转型升级发展

2.2.4未来经济发展展望

2.3社会环境

2.3.1移动网络运行状况

2.3.2研发经费投入增长

2.3.3科技人才队伍壮大

2.4技术环境 (Technological)

2.4.1企业研发投入

2.4.2技术迭代历程

2.4.3企业专利状况

第三章 2016-2020年半导体产业链发展状况

3.1半导体产业链分析

3.1.1半导体产业链结构

3.1.2半导体产业链流程

3.1.3半导体产业链转移

3.2 2016-2020年全球半导体市场总体分析

3.2.1市场销售规模

3.2.2行业产品结构

3.2.3区域市场格局

3.2.4产业研发投入

3.2.5市场竞争状况

3.2.6企业支出状况

3.2.7产业影响因素

3.2.8产业发展前景

3.3 2016-2020年中国半导体市场运行状况

3.3.1产业发展历程

3.3.2产业销售规模

3.3.3市场规模现状

3.3.4产业区域分布

3.3.5市场机会分析

3.4 2016-2020年中国IC设计行业发展分析

3.4.1行业发展历程

3.4.2市场发展规模

3.4.3企业发展状况

3.4.4产业地域分布

3.4.5专利申请情况

3.4.6资本市场表现

3.4.7行业面临挑战

3.5 2016-2020年中国IC制造行业发展分析

3.5.1制造工艺分析

3.5.2晶圆加工技术

3.5.3市场发展规模

3.6 2016-2020年中国IC封装测试行业发展分析

3.6.1封装基本介绍

3.6.2封装技术趋势

3.6.3芯片测试原理

3.6.4芯片测试分类

3.6.5市场发展规模

第四章 2016-2020年半导体设备行业发展综合分析

4.1 2016-2020年全球半导体设备市场发展形势

4.1.1市场销售规模

4.1.2市场结构分析

4.1.3市场区域格局

4.1.4重点厂商介绍

4.1.5厂商竞争优势

4.1.6市场发展预测

4.2 2016-2020年中国半导体设备市场发展现状

4.2.1市场销售规模

4.2.2市场需求分析

4.2.3市场竞争态势

4.2.4市场国产化率

4.2.5行业发展成就

4.3 半导体产业核心设备——晶圆制造设备市场运行分析

4.3.1设备基本概述

4.3.2核心环节分析

4.3.3主要厂商介绍

4.3.4厂商竞争格局

4.3.5市场发展规模

2016至2020年期间，中国半导体测试设备市场规模整体上呈增长趋势，2020年市场规模达

到176亿元左右，同比增长19.73%。随着国内封测厂陆续投入新产线，产能实现扩张，将持续带动国内半导体测试设备市场高速增长。

2016-2020年中国半导体测试设备市场规模及增速

4.4 半导体产业核心设备——晶圆加工设备市场运行分析

4.4.1 设备基本概述

4.4.2 市场发展规模

4.4.3 市场价值构成

4.4.4 市场竞争格局

第五章 2016-2020年半导体光刻设备市场发展分析

5.1 半导体光刻环节基本概述

5.1.1 光刻工艺重要性

5.1.2 光刻工艺的原理

5.1.3 光刻工艺的流程

5.2 半导体光刻技术发展分析

5.2.1 光刻技术原理

5.2.2 光刻技术历程

5.2.3 光学光刻技术

5.2.4 EUV光刻技术

5.2.5 X射线光刻技术

5.2.6 纳米压印光刻技术

5.3 2016-2020年光刻机市场发展综述

5.3.1 光刻机工作原理

5.3.2 光刻机发展历程

5.3.3 光刻机产业链条

5.3.4 光刻机市场规模

5.3.5 光刻机市场需求

5.3.6 光刻机竞争格局

5.3.7 光刻机技术差距

5.4 光刻设备核心产品——EUV光刻机市场状况

5.4.1 EUV光刻机基本介绍

5.4.2 典型企业经营状况

5.4.3 EUV光刻机需求企业

5.4.4 EUV光刻机研发分析

第六章 2016-2020年半导体刻蚀设备市场发展分析

6.1 半导体刻蚀环节基本概述

6.1.1 刻蚀工艺介绍

6.1.2 刻蚀工艺分类

6.1.3 刻蚀工艺参数

6.2 干法刻蚀工艺发展优势分析

6.2.1 干法刻蚀优点分析

6.2.2 干法刻蚀应用分类

6.2.3 干法刻蚀技术演进

6.3 2016-2020年全球半导体刻蚀设备市场发展状况

6.3.1 市场发展规模

6.3.2 市场竞争格局

6.3.3 设备研发支出

6.4 2016-2020年中国半导体刻蚀设备市场发展状况

6.4.1 市场发展规模

6.4.2 企业发展现状

6.4.3 市场需求状况

6.4.4 市场空间测算（图片）

第七章 2016-2020年半导体清洗设备市场发展分析

7.1 半导体清洗环节基本概述

7.1.1 清洗环节的重要性

7.1.2 清洗工艺类型比较

7.1.3 清洗设备技术原理

7.1.4 清洗设备主要类型

7.1.5 清洗设备主要部件

7.2 2016-2020年半导体清洗设备市场发展状况

7.2.1 市场发展规模

7.2.2 市场竞争格局

7.2.3 市场发展机遇

7.2.4 市场发展趋势

7.3 半导体清洗机领先企业布局状况

7.3.1 迪恩士公司

7.3.2 盛美半导体

7.3.3 至纯科技公司

7.3.4 国产化布局

第八章 2016-2020年半导体测试设备市场发展分析

8.1 半导体测试环节基本概述

8.1.1 测试流程介绍

8.1.2 前道工艺检测

8.1.3 中后道的测试

8.2 2016-2020年半导体测试设备市场发展状况

8.2.1 市场发展规模

8.2.2 市场竞争格局

8.2.3 细分市场结构

8.2.4 设备制造厂商

8.2.5 主要产品介绍

8.2.6 市场空间测算

8.3 半导体测试设备重点企业发展启示

8.3.1 泰瑞达

8.3.2 爱德万

8.4 半导体测试核心设备发展分析

8.4.1 测试机

8.4.2 分选机

8.4.3 探针台

第九章 2016-2020年半导体产业其他设备市场发展分析

9.1 单晶炉设备

9.1.1 设备基本概述

9.1.2 市场发展现状

9.1.3 企业竞争格局

9.1.4 市场空间测算

9.2 氧化/扩散设备

9.2.1 设备基本概述

9.2.2 市场发展现状

9.2.3 企业竞争格局

9.2.4 核心产品介绍

9.3 薄膜沉积设备

9.3.1 设备基本概述

9.3.2 市场发展现状

9.3.3 企业竞争格局

9.3.4 市场前景展望

9.4化学机械抛光设备

9.4.1设备基本概述

9.4.2市场发展现状

9.4.3市场竞争格局

9.4.4主要企业分析

第十章 国外半导体设备重点企业经营状况

10.1应用材料

10.1.1企业发展概况

10.1.2企业发展历程

10.1.3企业经营状况

10.1.4企业核心产品

10.1.5企业发展前景

10.2泛林集团

10.2.1企业发展概况

10.2.2企业经营状况

10.2.3企业核心产品

10.2.4企业发展前景

10.3阿斯麦

10.3.1企业发展概况

10.3.2企业经营状况

10.3.3企业核心产品

10.3.4企业发展前景

10.4东京电子

10.4.1企业发展概况

10.4.2企业经营状况

10.4.3企业核心产品

10.4.4企业发展前景

第十一章 国内半导体设备重点企业经营状况

11.1晶盛机电

11.1.1企业发展概况

11.1.2经营效益分析

11.1.3业务经营分析

11.1.4财务状况分析

11.1.5核心竞争力分析

11.2捷佳伟创

11.2.1企业发展概况

11.2.2经营效益分析

11.2.3业务经营分析

11.2.4财务状况分析

11.2.5核心竞争力分析

11.3北方华创

11.3.1企业发展概况

11.3.2经营效益分析

11.3.3业务经营分析

11.3.4财务状况分析

11.3.5核心竞争力分析

11.4中微公司

11.4.1企业发展概况

11.4.2经营效益分析

11.4.3业务经营分析

11.4.4财务状况分析

11.4.5核心竞争力分析

11.5中电科电子

11.5.1企业发展概况

11.5.2企业核心产品

11.5.3企业参与项目

11.5.4产品研发动态

11.5.5企业发展前景

11.6上海微电子

11.6.1企业发展概况

11.6.2企业发展历程

11.6.3企业参与项目

11.6.4企业创新能力

11.6.5企业发展地位

第十二章 对半导体设备行业投资价值分析

12.1半导体设备企业并购市场发展状况

12.2中国半导体设备市场投资机遇分析

12.2.1行业投资机会分析

12.2.2建厂加速拉动需求

12.2.3产业政策扶持发展

12.3对半导体设备投资价值评估及建议

12.3.1投资价值综合评估

12.3.2行业投资特点分析

12.3.3行业投资风险预警

12.3.4行业投资策略建议

第十三章 中国行业标杆企业项目投资建设案例深度解析

13.1半导体湿法设备制造项目

13.1.1项目基本概述

13.1.2资金需求测算

13.1.3投资价值分析

13.1.4建设内容规划

13.1.5经济效益分析

13.2半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目

13.2.1项目基本概述

13.2.2资金需求测算

13.2.3投资价值分析

13.2.4项目实施必要性

13.2.5实施进度安排

13.2.6经济效益分析

13.3光刻机产业化项目

13.3.1项目基本概述

13.3.2资金需求测算

13.3.3投资价值分析

13.3.4建设内容规划

13.3.5项目实施必要性

13.3.6经济效益分析

第十四章 对2021-2026年中国半导体设备行业发展趋势及预测分析

14.1中国半导体产业未来发展趋势(AK HZWY)

14.1.1技术发展利好

14.1.2自主创新发展

14.1.3产业地位提升

14.1.4市场应用前景

14.2中国半导体设备行业发展前景展望

14.2.1政策支持发展

14.2.2行业发展机遇

14.2.3 市场应用需求

14.2.4 行业发展前景

14.3 对2021-2026年中国半导体设备行业预测分析

14.3.1 2021-2026年中国半导体设备行业影响因素分析

14.3.2 2021-2026年中国大陆半导体设备销售规模预测

图表目录：

图表1 半导体分类结构图

图表2 半导体分类

图表3 半导体分类及应用

图表4 半导体设备构成

图表5 IC芯片制造核心工艺主要设备全景图

图表6 2016-2020年中国半导体设备行业相关产业政策（一）

图表7 2016-2020年中国半导体设备行业相关产业政策（二）

图表8 《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/yzsb/705090.html>